

## NC275B 免洗液态助焊剂

### 特性

- ▶ 无 VOC
- ▶ 无卤素/卤化物
- ▶ 工艺应用窗口广泛
- ▶ 中等残留物
- ▶ 符合 REACH 标准
- ▶ 高活性

### 描述

NC275B 液态助焊剂是一种水基无 VOC 助焊剂，其性能和可靠性与许多醇基助焊剂相当甚至更好。NC275B 助焊剂可产生中量的残渣，适用于所有常见的无铅波峰焊合金，包括锡银铜、锡银、锡铜等。NC275B 高活性特性解决了许多无铅合金常见的孔环填充和润湿问题。NC275B 焊后残留物可选择保留，或用适当的清洗剂清除。

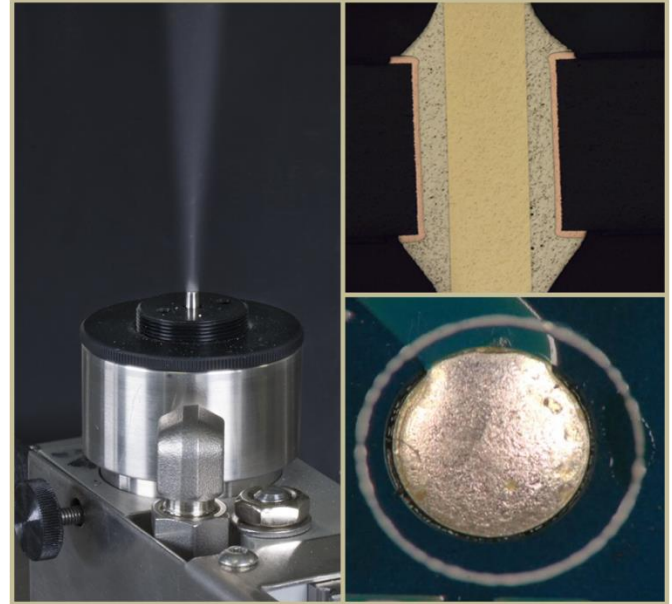
### 应用

NC275B 可用于喷涂或喷雾。不建议使用起泡方式。NC275B 可直接使用，无需稀释。当喷焊时，需适当的助焊剂均匀覆盖。每平方英尺建议 500-1500 微克。当使用氮气保护波峰焊设备时，可能需要使用额外的助焊剂。

### 工艺指导

使用热电偶连接PCB板顶部，在接触焊料波之前，上部组件温度应立即在100-135°C (212-275°F)之间。与所有水基焊剂一样，对流式预热器提供了更宽的工艺窗口。无论温度如何，在进入波峰焊之前，助焊剂必须干燥，否则会发生飞溅。有些烟雾是正常的。建议的焊料波接触时间取决于波的结构、炉温、合金类型和组件的热质量，一般情况下为4-7秒。如需工艺的帮助，请通过以下链接联系AIM技术支持。

<http://www.aimsolder.com/technical-support-contacts>.



### 处理& 储存

参数	时间	温度
密封储存时间	1 年	室温

NC275B 在常温密封储存保质期为一年。请勿存放在明火附近。避免阳光照射，否则会使产品降解。NC275B 是即用型，无需搅拌。请勿在同一容器中混合使用过的和未使用过的产品。重新密封所有打开未使用的产品。

### 清洁

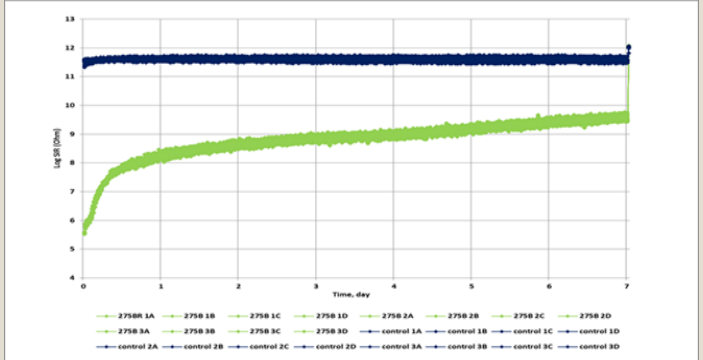
NC275B 可以用皂化剂或化学清洗剂清洗。联系 AIM 获取更多信息。推荐使用去离子水进行最终冲洗。

### 安全

使用时应有足够的通风和适当的个人防护设备。有关紧急情况的信息，请参阅随附的安全数据表。不要在未经批准的容器中处理任何危险品。

## 测试数据总结

名称	测试方法	结果	
IPC 分类	J-STD-004	ORL0	
IPC 分类	J-STD-004B 3.3.1	ORL0	
名称	测试方法	结果	图像
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Before</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>After</p>  </div> </div>
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br 0.0% Cl: 0.0%	
定量卤化物、铬酸银测试	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	

名称	测试方法	结果	图像
定量卤化物、氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟化物	
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	所有测试模板上的测量都超过100 MΩ	
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	3.95 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	31.3 典型值	
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	1.00 典型值	
pH 值	ASTM D5464 ASTM G51	2.62 典型值	
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	无色	
润湿性	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	通过	